



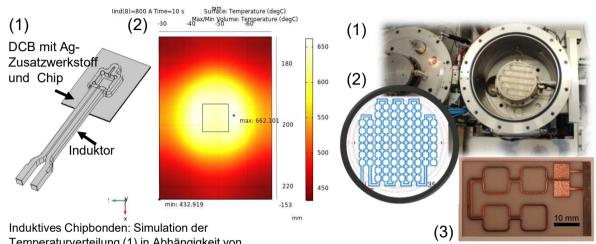
Schwerpunkte: Fügen in der Mikro- und Dünnschichttechnik

Anwendungen

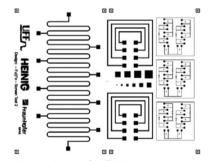
- induktives Bonden auf Wafer- und Chip-Level
- induktives Sintern von n/µ-Partikelpasten für Chipmontage, für die Erzeugung von Leiterbahnen, als Alternative zum Weichlöten
- Folienschweißen in der Verpackungsindustrie und der Elektronik

F&E-Schwerpunkte

- Auslegung und numerische Simulation von induktiven Erwärmungsprozessen
- quantitative und qualitative thermische Analyse
- Realisierung von Versuchsständen
- Durchführung induktiver Fügeprozesse
- Analyse und Qualifizierung der erzeugten Fügeverbindungen



Temperaturverteilung (1) in Abhängigkeit von der Induktorgeometrie (2)



Leiterbahnenlayout für Folientastaturen zur Herstellung mittels induktivem Niedertemperatursintern.

(1) Waferbondanlage mit induktivem Bondmodul, (2) Schematische Darstellung eines 6-Zoll-Wafers mit 84 Rahmen, überdeckt durch einen Induktor mit angepasster geometrischer Form. (3) Mikrospule aus Kupfer auf AIN-Chip (Fraunhofer ENAS)

Ansprechpartner:

M.Sc. Patrick Rochala

Telefon: +49 371 531-34081

E-Mail: patrick.rochala@mb.tu-chemnitz.de

M.Sc. Sushant Panhale Telefon: +49 371 531-39080

E-Mail: sushant.panhale@mb.tu-chemnitz.de